

檔 號：  
保存年限：

## 科技部 書函

地址：台北市和平東路二段106號  
聯絡人：何幸蓉 助理研究員  
電話：02-2737-7932  
傳真：02-2737-7619  
電子信箱：srhe@most.gov.tw

受文者：開南大學

發文日期：中華民國108年5月8日  
發文字號：科部產字第1080028430號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文 (108TOP001704\_108D2011087-01.pdf)

主旨：函轉經濟部智慧財產局徵求「2019台灣創新技術博覽會」  
發明競賽參展訊息，請踴躍報名參展，以共同促進專利技  
術商品化與產業化，請查照。

說明：依經濟部智慧財產局108年5月7日智國企字第10811003960  
號函辦理，影送來函1份。

正本：本部各所屬機關（共3單位）、專題研究計畫受補助單位（共305單位）  
副本：本部各司處（共22單位）（含附件）



科技部